

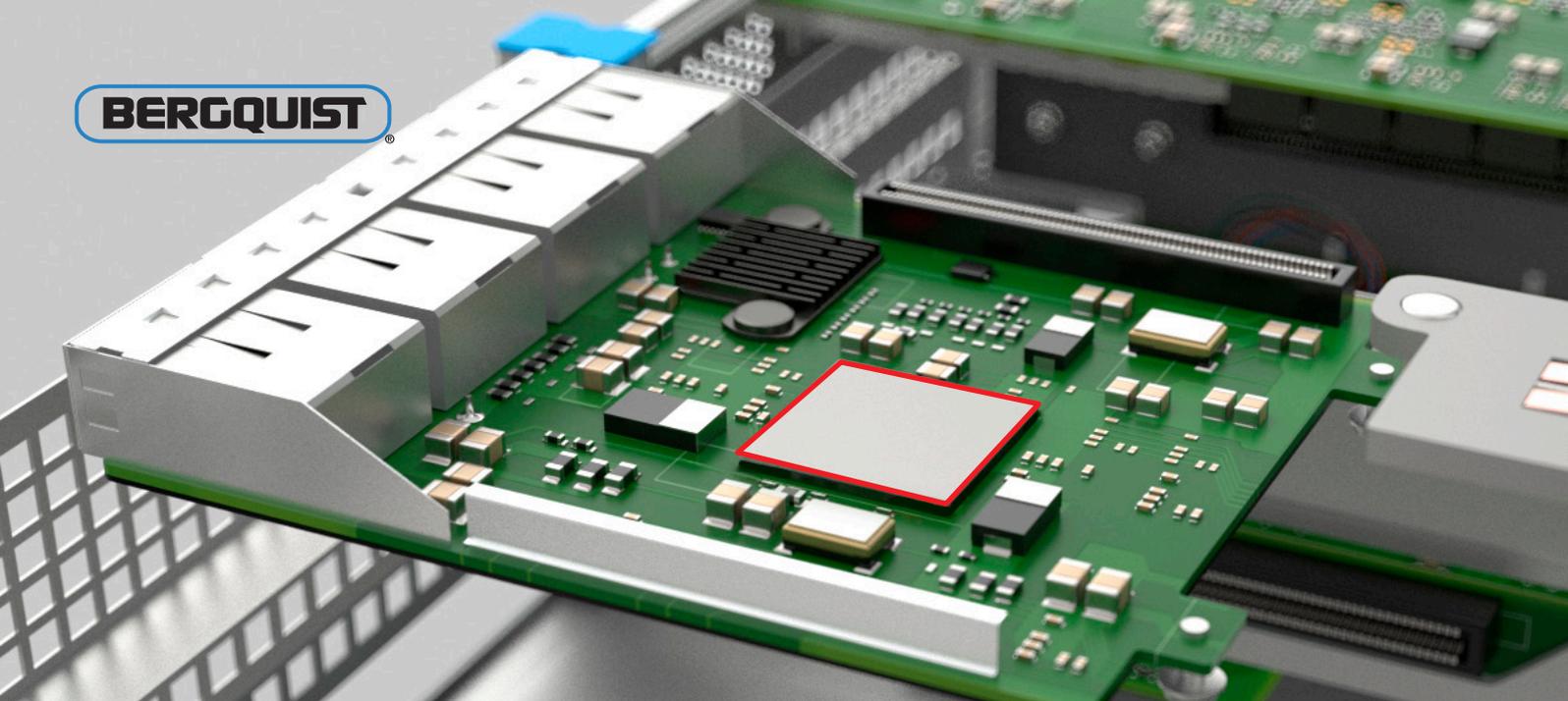
BERGQUIST®

BERGQUIST® HI FLOW THF 5000UT

次世代集積回路の 高性能化

Henkel

Henkel Adhesive Technologies



最先端デバイスに適した薄いボンドラインと優れた熱制御を低加圧で実現

BERGQUIST® HI FLOW THF 5000UT は優れた熱性能をもたらす画期的なシート状フェーズチェンジサーマルインターフェース材 (TIM) です。薄いボンドラインと極低圧 (< 69 kPa) および高圧 (> 241 kPa) での低サーマルインピーダンスによって、ストレスを最小限に抑えながら優れた熱性能を発揮します。BERGQUIST® HI FLOW THF 5000UT は室温では固形ですが、所定の温度 (45°C) に達すると流動性を示し、ミクロな凹凸に入り込みます。5.3 W/m・K の熱伝導率を達成し、ポンプアウトが少なく、最高 150°C まで優れた信頼性を発揮することが実証されています。

※一定条件下では8.5 W/m・Kの熱伝導率を達成します。

用途

- ≫ クラウドセンター、5G 通信インフラ、産業オートメーション、車載用途
- ≫ グリースと比べ、低い熱抵抗で安定した性能と作業性を有する薄いボンドラインのサーマルインターフェース材を必要とするシステム
- ≫ 高度な演算およびネットワーク用のリッドレスマルチチップパッケージなど設計が複雑で要求が厳しい集積回路

メリット

- ≫ 低熱抵抗による優れた熱伝導性
- ≫ 低圧用途で市場をリードする性能を発揮 (< 69 kPa)
- ≫ ボンドライン厚や圧力が変化しても安定した性能を発揮
- ≫ 最高 150°C で高信頼性を発揮
- ≫ 加熱等の硬化プロセスが不要、時間とエネルギーを削減してサステナビリティを実現
- ≫ あらかじめ部材に装着することにより部材調達と現場作業の簡易化を実現

特性

- ≫ リッドレスマルチチップに最適:
0.06°C -cm² /W (< 69 kPa)
- ≫ 低サーマルインピーダンス:
0.04°C -cm² /W (241 kPa)
- ≫ 優れた信頼性:
-40 ~ 125°C -1000 サイクル
85°C /85% RH-1000 時間
125°C /85% RH-1000 時間
150°C /85% RH-1000 時間
- ≫ モジュール組付け時の加熱は不要
- ≫ 最小 25 μm の薄いボンドラインに対応
- ≫ 0.2、0.25、0.3、0.4 mm の厚みをラインアップ
- ≫ 北米およびアジアで製造して世界各地に供給

ヘンケルジャパン株式会社

〒235-0017 横浜市磯子区新磯子町27-7
TEL : 045 (758) 1800
henkel-adhesives.com/jp

接着に関する技術的なお問い合わせは

045-758-1842

JP.AE-CSdesk@henkel.com

本製品をご使用になる前に下記事項をご承諾下さい。

1. 本製品のご使用にあたっては、用途・目的に適合するか否かを必ずご使用になられる方ご自身で検討いただき、最終判断を下して下さい。2. 本製品の取り扱いに関しては、ご使用になる前にご使用になられる方ご自身が十分に検討し、安全にご使用下さい。3. 本書に記載されている事項は現時点での最終情報であり、予告無く改定することがあります。4. 弊社の管理の及ばない製造物、施工物の不具合に関する損害補償は致し兼ねます。

記載されている商品の仕様およびデザインは、2023年7月現在のもので、改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。 L306-2307A (AI)

※無断転載・転用を禁止します。(写真・文章)



▲ 動画はこちら